

株式会社 アルバック

2024年6月期 WEB 決算説明会（2024年8月13日開催）およびアナリストミーティングの主な質疑応答

【24/6期実績】

1. 受注高・売上高・営業利益が計画を上回った要因は？24/6期3Qの説明よりも上振れたのはなぜか？

A: 受注高は、2,582億円となり計画を82億円上回った。一般産業、材料などが上回った。

売上高は、受注高の増加及び高水準の期初受注残高1,410億円の寄与に加えて、FPDや半導体電子等の今期からの一部前倒し等もあり、計画を161億円上回る2,611億円となった。計画比では、コンポーネント、材料、FPD、半導体電子などが上回った。

営業利益は、売上が計画を上回ったことから298億円と計画を68億円上回った。

3Q開示時の説明よりも上振れたのは、①若干堅めにみていたこと、②顧客要請等もあり工程進捗が早まったこと、③材料ビジネスが想定以上に受注・売上に貢献したことなどによる。

2. 売上総利益率が上場来最高水準となった主な要因は？一方で、売上総利益率が、3Q（33.8%）に対して4Q（30.7%）は3.1pt低下した理由は？

A: ①パワーデバイスやバッテリー関連の売上が増加し、売上増加とミックス改善の効果により着実に利益体質が向上してきた。また、②3Qは半導体・電子等で利益率の高い案件が貢献し、通期の売上総利益率改善にも貢献した。

3Qは一時的な特殊要因もあり33.8%と上場来最高水準となったが、4Qはこれらの特殊要因が無くなったことに加え、

①半導体電子・コンポーネントの3Q比ミックス悪化

②グループ会社の表面分析装置の売上が利益率の低い地域に集中したことなどの影響も加わり、低下した。

3. 24/6期の半導体電子部品およびFPDの受注高・売上高の用途別内訳、品目別の営業利益率の順位は？

A: 別紙のとおり。

【25/6期計画】

4. 25/6期は、下期から売上高・営業利益（率）改善する計画となっているがなぜか？

A: 24/6期4Qに今上期（1Q）に見込んでいた売上が顧客要請等もあり前倒しになったため、上期（1Q）の売上高は低い水準からのスタートとなり、下期にかけて増加していく計画。営業利益（率）も売上増加と共に増加・改善していく。1Qは前期への前倒しがあったこともあり、スロースタートとなる見込み。

5. 25/6期の半導体電子部品およびディスプレイ・エネルギーの受注高・売上高の用途別内訳は？

A: 別紙のとおり。

【中期経営計画の進捗】

6. 中期経営計画の最終年度である 26/6 期の売上総利益率は 25/6 期比 2.6pt の大幅改善を見込んでいるが、どのように実現するのか？

A: 計画的生産移行等によるモノづくり力強化への取り組みに加え、半導体・電子・バッテリー等の成長ドライバーの貢献や OLED ビジネス・リークテスト装置・表面分析装置などのビジネス拡大による売上高増加や相対的に利益率の高い半導体・電子・コンポーネントの増加によるミックス改善等により達成を目指す。

売上増加とミックス改善で 8 割程度、計画的生産に伴うモノづくり力強化で 2 割程度、利益率改善に貢献すると考えている。

【成長ドライバー】

7. メモリ・ロジックの半導体ビジネスについて、どのような見通しなのか？

A: ① メモリ

メモリ投資は在庫調整局面から DRAM 中心に投資回復局面に移行しており、NAND 投資も徐々に回復するものと考えている。セカンドベンダーとしての期待もあり、配線周りの工程などで新しい工程へのチャンスも広がっており、更なる成長を目指す。

② ロジック

先端ロジック投資も調整局面から投資回復局面に移行し始めている。24/6 期には、MHM 工程で 3 社目の北米ロジックメーカー、4 社目の日本メーカーからの採用が決まった。加えて、トランジスタ周辺工程（FEOL）への採用も決まるなど新規ビジネスが増えたことでロジック分野のビジネス基盤が拡大してきている。25/6 期には、24/6 期採用の新規ビジネスが既存ビジネスとして加わり、さらに配線周りの新しい工程での採用も狙うことでロジックビジネスを更に伸ばしていく。

8. 生成 AI 関連のビジネスをどの程度織り込んでいるか？

A: 生成 AI 関連として、24/6 期には DRAM について HBM 関連の増産投資で約 60 億円、先端パッケージング向けアッシング装置約 80 億円、合計 140 億円程度の受注があった。25/6 期においても、それぞれ 100 億円程度、合計 200 億円程度の受注を見込む。

9. 今後のパワーデバイスの見通しについて教えてほしい。

A: グリーンエネルギー化や EV 化に伴う SiC パワーデバイス需要の中長期的な増加が見込まれており、6 inch から 8 inch へのウエハーサイズアップやトレンチ構造化などに伴うビジネスチャンスの拡大が期待されている。

足下は EV 市場の成長が鈍化しているため、8 inch 化投資計画が半年から 1 年程度ずれ込み、来期にかけて横ばい程度で推移し、27 年 6 月期以降、本格的な投資が進められると見込んでいる。

SiC 6 inch 向けでは、スパッタリング装置が日本市場で 7 割のシェアを確保、イオン注入装置は中国市場で 7 割のシェアを確保しており、8 inch にシフトする際も高いシェアを維持していく。さらに、日本市場では、スパッタリング装置に加え、中国市場で実績のあるイオン注入装置やトレンチ構造化によるエッチング装置のクロスセルを推進し、中国市場ではイオン注入装置に加え、日本市場で実績のあるスパッタリング装置のクロスセルを推進していく。

また、Si-MOSFET 向けでは、カスタマイズ対応・中国現地生産による価格競争力を強みにして、蒸着装置を引き続き拡販していく。

10. パワーデバイスの 24/6 期・25/6 期の受注は、方式別・地域別・装置別でどのような構成比か？

A: 24/6 期 年間

・SiC 関連：8 割強、Si-MOSFET 関連：1 割強、IGBT 関連：一桁台半ば%

・中国：6 割、日本：4 割。

・イオン注入装置：5 割強、スパッタ装置：3 割半ば、Si-MOSFET 向け蒸着装置：1 割強

25/6 期も 24/6 期と同じような構成比になる見込み

11. バッテリー関連が今期あまり伸びないのはなぜなのか？投資マインドに変化があるのか？

A: EV バッテリーの正極集電体のアルミ両面蒸着膜への置き換えに対する投資意欲は依然高く、各社とも装置を設置するための大規模工場の用地確保や建設を進めるなど、生産体制強化に対するマインドに変化はないと感じている。丁度、今、23/6 期 4Q～24/6 期 1Q に集中的に受注した装置の試運転や確認作業を各社工場で実施している段階である。また、両面蒸着膜を採用した EV バッテリーの車載搭載の認証等に時間を要している面もあるようである。このため、当初想定したよりも第 2 次投資がずれ込んでおり、今期は前期並みを見込む。ただし、各社の投資意欲は引き続き旺盛で、26/6 期からの投資本格化の見込みに変更は無い。

12. バッテリービジネスは 26/6 期以降に拡大するのか？

A: バッテリーの安全性向上・小型軽量化等を目的として、従来使われている正極集電体のアルミ箔からアルミの両面蒸着膜への置き換え需要であるため、EV 化の減速の影響は限定的と見込んでいる。車載への採用の進展とともに投資は本格化するとみている。

今後ともアルミ両面蒸着膜のフィルム幅広化によりさらに生産性を向上させ、差別化を図り、市場シェアを確保していく。

また、銅の両面蒸着膜向け装置を開発し、負極集電体の置き換えも進めることでビジネスの拡大を目指す。

将来の取り組みとして、リチウムを用いた次世代電池負極の開発を進めることで、更なる成長を目指していく。

13. OLED ビジネスの投資動向について教えてほしい。

A: 今期よりタブレット・PC 向け IT パネル用 OLED の投資が本格化する。従来のスマホ用 G6 パネルよりも大きい G8.7 パネルサイズに対応し、テレビ用 G8～G10.5 パネルの製造で用いていたインライン型から、よりパーティクルの少ない半導体仕様の枚葉型スパッタリング装置を開発済。また、タッチセンサー用に透明電極をスパッタリングする際、温度に敏感な OLED プロセスで低温成膜による高速成膜で高い生産性を実現している。これらの強みを活かして市場シェアを確保していく。上期には大口受注予定である。

OLED 蒸着装置向けクライオポンプは、競合と比べてポンプの振動が少ないため、蒸着マスクのアライメント（位置決め）への影響を最小限に抑えることができ、高い排気性能や省エネの強みがある。OLED 蒸着装置向けではデファクトスタンダードとなっており、IT パネル用 OLED でもしっかりとビジネスチャンスを掴んでいきたい。

14. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？

A: 現状は、中国の半導体関連のビジネスウエイトはそれほど大きくないが、引合いもいただいております。徐々に伸ばしていきたい。中国の半導体関連は計画としてはそれほど大きな金額で織り込んでおらず、万一、米国による規制が強化されても影響は限定的。パワーデバイスや各種電子デバイス、バッテリー関連等に規制が及ぶという話も聞いておらず、現時点ではビジネスへの影響は感じていない。

以上

24/6期実績 品目別内訳割合

●受注高 品目別・内訳割合

受注高	24/6期 通期
半導体電子（億円）	875
・メモリ	1割半ば
・ロジック	2割強
・電子部品	2割強
・パワー半導体	3割半ば
・実装	1割弱
・その他	-
FPD（億円）	524
・LCD	3割強
・OLED	4割弱
・バッテリー	3割弱
・その他	数%

●売上高 品目別・内訳割合

売上高	24/6期 通期
半導体電子（億円）	959
・メモリ	2割弱
・ロジック	2割弱
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	3割強
・実装	1割弱
・その他	-
FPD（億円）	551
・LCD	4割強
・OLED	3割弱
・バッテリー	2割半ば
・その他	一桁台半ば

●営業利益率順位 24/6期 通期

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	一般産業
4	その他
5	FPD
6	材料

全社平均利益率は
 3) 一般産業と
 4) その他との間

25/6期計画 品目別内訳割合

●受注高 品目別・内訳割合

受注高	25/6期 通期
半導体電子（億円）	940
・メモリ	2割強
・ロジック	2割強
・電子部品	約2割
・パワー半導体	3割弱
・実装	1割弱
・その他	-
ディスプレイ・エネルギー（億円）	566
・LCD	2割強
・OLED	5割弱
・バッテリー	2割半ば
・その他	一桁台半ば

●売上高 品目別・内訳割合

売上高	25/6期 通期
半導体電子（億円）	1,030
・メモリ	2割弱
・ロジック	約2割
・電子部品	2割強
・パワー半導体	3割強
・実装	1割弱
・その他	-
ディスプレイ・エネルギー（億円）	550
・LCD	3割強
・OLED	4割弱
・バッテリー	2割半ば
・その他	数%